

Germany-Frankfurt (Oder): Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

OJ S 109/2021 08/06/2021

Contract notice

Supplies

Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1. Name and addresses

Official name: IHP GmbH – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik

Postal address: Im Technologiepark 25

Town: Frankfurt (Oder)

NUTS code: DE403 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

Postal code: 15236

Country: Germany

Contact person: Beschaffung

E-mail: rohner@ihp-microelectronics.com

Telephone: +49 335-5625-359

Fax: +49 335-5625-25359

Internet address(es):

Main address: <https://www.ihp-microelectronics.com/en/start.html>

I.3. Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: <https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYYV4/documents>

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:

<https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXSTYYDYYV4>

I.4. Type of the contracting authority

Other type: Forschung und Entwicklung

I.5. Main activity

Other activity: Forschung und Entwicklung

Section II: Object

II.1. Scope of the procurement

II.1.1. Title

Automatische Doppelspindel-Wafersäge zur Bearbeitung von Wafern

Reference number: IHP-2021-046

II.1.2. Main CPV code

38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

II.1.3. Type of contract

Supplies

II.1.4. Short description

Automatische Doppelspindel-Wafersäge zur Bearbeitung von Wafern mit max. 200 mm Durchmesser verschiedener Dicken ca. 75 µm bis 1.6 mm dicken Wafern bzw. Waferteilen im Full-Cut-, Halfcut- oder Circle-Cut-Verfahren und anschließendem Cleaning-Prozess Doppelspindelsäge

Allgemeine Informationen:

- Anlage zum Dicing an 200 mm BiCMOS Wafern, für Blade Dicing Prozesse (Full Cut, Half Cut, Circle Cut),
- Möglichkeit für funktionale Erweiterung des Tools für zukünftigen Forschungsaktivitäten des IHP (z. B. Softwareerweiterungen, Hardwareerweiterungen).

Erforderliche Funktionen des Doppelspindelsäge:

- Zweispindelsystem (paralleles Sägen),
- Sägetiefengenauigkeit: $\pm 5 \mu\text{m}$,
- Positioniergenauigkeit Waferebene: $\pm 2 \mu\text{m}$,
- Vollautomatisches Roboter Handlingsystem für 200 mm Wafer und Waferstacks (Dicke von 0,7 - 1,6 mm) ohne Backsidetape & ohne Frame (Box-to-Box-Handling),
- Boxenaufnahme kompatibel zu vorhandenen 200 mm Waferboxen,
- Automatische inline Reinigungsfunktion für Substrate zur Vermeidung der Eintrocknung von Sägeresten auf Waferoberfläche,
- Automatisierte Reinigung der relevanten Handlingkomponenten,
- Automatisches Sägetiefensetup, inkl. Überprüfung der Sägeblattkontur,
- Automatische Dress und Flatdressfunktion,
- Inline-System zur Verhinderung der Oxidation von offengelegten Metallkontakten auf den BiCMOS-Wafern,
- Startset Sägeblätter (grobe und feine) und Dresserboards,
- Training für Prozesse und Anlagenbedienung/-instandhaltung am IHP oder in Deutschland,
- Technische Unterlagen und Anleitungen in gedruckter und digitaler Form in deutscher Sprache,
- System passend für deutsches Stromnetz, 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Optionale Funktionen der Doppelspindelsäge:

- Säge- und DBG-Funktion (Dicing Before Grinding), inkl. Handlingsysteme und Boxen,
- ggf. notwendige Umrüstarbeiten sollen mit möglichst geringem Aufwand umsetzbar sein.

Service:

Zur Einarbeitung im Umgang mit dem beschriebenen Tool werden 2 Mitarbeiter des IHP nach erfolgtem Abschluss der Equipment Installation in einem angemessenen Zeitrahmen (min. 4 Tage) geschult. Weiterhin werden entsprechende Prozesse und Rezepte für Standardwafer aufgesetzt, um eine sich direkt anschließende Bearbeitung zu ermöglichen.

Beim Verlassen eines geschulten Mitarbeiters verpflichtet sich der Bieter, einen vom IHP zu bestimmenden Mitarbeiter, erneut zu schulen.

Weiterhin ist die nachfolgende Unterstützung durch mindestens 20 zusätzliche Prozess-bzw. Maintenance Supporttage Inhalt der Ausschreibung.

Maintenance- und Supportanfragen sind vom Bieter zeitnah zu bearbeiten (1-2 Wochen).

Zusätzliche Informationen:

Die Anlagen müssen nach geltendem europäischen, deutschem und brandenburgischem Recht hergestellt werden, was durch eine EG-Konformitätserklärung nachzuweisen ist. Dazu müssen die Bieter dem IHP die erforderlichen Informationen zukommen lassen. Weiterhin muss nachgewiesen werden, dass die entsprechenden Anlagen schon bei anderen Forschungseinrichtungen/Firmen im Bereich der Halbleiterbranche erfolgreich eingesetzt wird. Eine zweijährige Garantie, anlagen- und prozesstechnische Unterstützung beim Einfahren des

Tools sowie die Lieferung entsprechender Hardware und Rezepte der Demoversuche sind Inhalt der Ausschreibung. Eine Lieferung, Installation und technischen Abnahme bis Ende Q1 2022 ist unbedingt erforderlich. Das Tool soll in einem Labor installiert und verwendet werden und muss damit die entsprechenden Anforderungen bezüglich Reinheit erfüllen.

II.1.5. Estimated total value

II.1.6. Information about lots

This contract is divided into lots: no

II.2. Description

II.2.3. Place of performance

NUTS code: DE403 Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

Main site or place of performance: IHP GmbH – Leibniz-Institut für innovative Mikroelektronik
Im Technologiepark 25 15236 Frankfurt (Oder)

II.2.4. Description of the procurement

Automatische Doppelspindel-Wafrersäge zur Bearbeitung von Wafern mit max. 200 mm Durchmesser verschiedener Dicken ca. 75 µm bis 1.6 mm dicken Wafern bzw. Waferteilen im Full- Cut-, Halfcut- oder Circle-Cut-Verfahren und anschließendem Cleaning-Prozess

Doppelspindelsäge

Allgemeine Informationen:

- Anlage zum Dicing an 200 mm BiCMOS Wafern, für Blade Dicing Prozesse (Full Cut, Half Cut, Circle Cut),
- Möglichkeit für funktionale Erweiterung des Tools für zukünftigen Forschungsaktivitäten des IHP (z. B. Softwareerweiterungen, Hardwareerweiterungen).

Erforderliche Funktionen der Doppelspindelsäge:

- Zweispindelsystem (paralleles Sägen),
- Sägetiefengenauigkeit: +/- 5 µm,
- Positioniergenauigkeit Waferebene: +/- 2 µm,
- Vollautomatisches Roboter Handlingsystem für 200 mm Wafer und Waferstacks (Dicke von 0,7 – 1,6 mm) ohne Backsidetape & ohne Frame (Box-to-Box-Handling),
- Boxenaufnahme kompatibel zu vorhandenen 200 mm Waferboxen,
- Automatische inline Reinigungsfunktion für Substrate zur Vermeidung der Eintrocknung von Sägeresten auf Waferoberfläche,
- Automatisierte Reinigung der relevanten Handlingkomponenten,
- Automatisches Sägetiefensetup, inkl. Überprüfung der Sägeblattkontur,
- Automatische Dress und Flatdressfunktion,
- Inline-System zur Verhinderung der Oxidation von offengelegten Metallkontakten auf den BiCMOS-Wafern,
- Startset Sägeblätter (grobe und feine) und Dresserboards,
- Training für Prozesse und Anlagenbedienung/-instandhaltung am IHP oder in Deutschland,
- Technische Unterlagen und Anleitungen in gedruckter und digitaler Form in deutscher Sprache,
- System passend für deutsches Stromnetz, 400 V, 3 Phasen, 50 Hz.

Optionale Funktionen der Doppelspindelsäge:

- Säge- und DBG-Funktion (Dicing Before Grinding), inkl. Handlingsysteme und Boxen,
- ggf. notwendige Umrüstarbeiten sollen mit möglichst geringem Aufwand umsetzbar sein.

Service:

Zur Einarbeitung im Umgang mit dem beschriebenen Tool werden 2 Mitarbeiter des IHP nach erfolgreichem Abschluss der Equipment Installation in einem angemessenen Zeitrahmen (min. 4

Tage) geschult. Weiterhin werden entsprechende Prozesse und Rezepte für Standardwafer aufgesetzt, um eine sich direkt anschließende Bearbeitung zu ermöglichen.

Beim Verlassen eines geschulten Mitarbeiters verpflichtet sich der Bieter, einen vom IHP zu bestimmenden Mitarbeiter, erneut zu schulen.

Weiterhin ist die nachfolgende Unterstützung durch mindestens 20 zusätzliche Prozess-bzw. Maintenance Supporttage Inhalt der Ausschreibung.

Maintenance- und Supportanfragen sind vom Bieter zeitnah zu bearbeiten (1-2 Wochen).

Zusätzliche Informationen:

Die Anlagen müssen nach geltendem europäischen, deutschem und brandenburgischem Recht hergestellt werden, was durch eine EG-Konformitätserklärung nachzuweisen ist. Dazu müssen die Bieter dem IHP die erforderlichen Informationen zukommen lassen. Weiterhin muss nachgewiesen werden, dass die entsprechenden Anlagen schon bei anderen Forschungseinrichtungen/Firmen im Bereich der Halbleiterbranche erfolgreich eingesetzt wird. Eine zweijährige Garantie, anlagen- und prozesstechnische Unterstützung beim Einfahren des Tools sowie die Lieferung entsprechender Hardware und Rezepte der Demoversuche sind Inhalt der Ausschreibung. Eine Lieferung, Installation und technischen Abnahme bis Ende Q1 2022 ist unbedingt erforderlich. Das Tool soll in einem Labor installiert und verwendet werden und muss damit die entsprechenden Anforderungen bezüglich Reinheit erfüllen.

II.2.5. Award criteria

Criteria below

Price

II.2.6. Estimated value

II.2.7. Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 1

This contract is subject to renewal: no

II.2.10. Information about variants

Variants will be accepted: no

II.2.11. Information about options

Options: no

II.2.13. Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds:
no

II.2.14. Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1. Conditions for participation

III.1.2. Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:

— Bescheinigung in Steuersachen.

Der AG behält sich vor Auftragsvergabe vor, eine Anfrage bei dem zuständigen Anti-Korruptionsregister sowie beim Gewerbezentralregisteramt durchzuführen.

III.1.3. Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:

Referenzen:

Es werden vergleichbare auftragsbezogene Firmenreferenzen in Bezug zur ausgeschriebenen Leistung erwartet. Vergleichbar heißt Referenzen in Zusammenarbeit mit dem Auftrag. Die Referenzen sind als Art Referenzbescheinigung durch den Bieter mit den folgenden Angaben mit der Angebotsabgabe einzureichen:

- Referenzgeber,
- Ansprechpartner des Referenzgebers inklusive Telefonnummer,
- Zeitraum Beginn/Ende der Ausführung,
- Kurzbeschreibung des Auftragsumfangs.

Section IV: Procedure

IV.1. Description

IV.1.1. Type of procedure

Open procedure

IV.1.3. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

IV.1.8. Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

IV.2. Administrative information

IV.2.2. Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date: 06/07/2021 Local time: 12:00

IV.2.3. Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates

IV.2.4. Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

German

IV.2.6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Tender must be valid until: 03/09/2021

IV.2.7. Conditions for opening of tenders

Date: 06/07/2021 Local time: 12:00

Place:

Frankfurt (Oder)

Section VI: Complementary information

VI.1. Information about recurrence

This is a recurrent procurement: no

VI.3. Additional information

Die Vergabeunterlagen finden Sie auf dem Vergabemarktplatz Brandenburg

<http://vergabemarktplatz.brandenburg.de>

Sie können sich gern freiwillig auf der Vergabeplattform Vergabemarktplatz Brandenburg registrieren und die Vergabeunterlagen dort herunterladen.

Dies bietet Ihnen den Vorteil, dass Sie automatisch über Änderungen in den Vergabeunterlagen oder über Antworten auf Fragen zum Vergabeverfahren informiert werden.

Registrieren Sie sich nicht, besteht eine entsprechende Holschuld, das heißt, Sie müssen sich selbstständig informieren, ob die Vergabeunterlagen zwischenzeitlich geändert wurden und ob wir Bieterfragen zum Vergabeverfahren beantwortet haben.

Wir weisen darauf hin, dass für das Stellen einer Frage zum Verfahren und für das Abgeben eines Angebotes und – sofern im konkreten Verfahren einschlägig – für das Einreichen eines Teilnahmeantrages oder für das Abgeben einer Interessenbestätigung ohnehin eine Registrierung unumgänglich ist.

Die Teilnahmeunterlagen und Angebotsunterlagen müssen scannbar eingereicht werden und sollten nicht gebunden oder geklammert werden.

Bekanntmachungs-ID: CXSTYYDYYV4

VI.4. Procedures for review

VI.4.1. Review body

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

Telephone: +49 331 / 866-1719

Fax: +49 331 / 866-1652

VI.4.2. Body responsible for mediation procedures

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

Telephone: +49 331 / 866-1719

Fax: +49 331 / 866-1652

VI.4.4. Service from which information about the review procedure may be obtained

Official name: Vergabekammer des Landes Brandenburg beim Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten

Postal address: Heinrich-Mann-Allee 107

Town: Potsdam

Postal code: 14473

Country: Germany

Telephone: +49 331 / 866-1719

Fax: +49 331 / 866-1652

VI.5. Date of dispatch of this notice

03/06/2021